



美光業界首款搭載 LPDDR5 的 uMCP 產品 正式送樣 以提升 5G 智慧型手機效能和電池續航力

*多晶片封裝將 LPDRAM、NAND 與內建控制器相結合
節省 40% 主機板空間*

2020 年 3 月 10 日，美國加州聖荷西—美光科技公司 (Nasdaq: MU) 今日宣布開始業界首款搭載 LPDDR5 DRAM 的通用快閃記憶體儲存 (UFS) 多晶片封裝 (uMCP) 正式送樣。uMCP 提供高容量和低功耗儲存，專為輕薄小巧的中階智慧型手機設計。

新款 UFS 多晶片封裝 (uMCP5) 是基於美光在多晶片規格尺寸上的創新及領導地位所打造的。美光的 uMCP 將 LPDRAM、NAND 和內建控制器相結合，較雙晶片解決方案減少 40% 佔用空間。最佳化的配置可節省功耗、減少記憶體佔用空間，並支援更小巧靈活的智慧型手機。

美光資深副總裁暨行動裝置事業部總經理 Raj Talluri 博士說：「此款業界首創的封裝解決方案搭載最新 LPDRAM 和 UFS 介面，可將記憶體和儲存頻寬提高 50%，並降低功耗。美光最新的 uMCP5 滿足中階 5G 智慧型手機對超低延遲運行、低功耗模式的頻寬需求，能支援多項如高解析度影像處理、多人連線遊戲及 AR/VR 應用的旗艦手機功能。」

美光 uMCP5 採用先進的 1y nm DRAM 製程技術及世界上最小的 512Gb 96 層 3D NAND 晶粒。該新型封裝解決方案採 297 球柵陣列封裝 (BGA)，支援雙通道 LPDDR5，速度高達 6,400Mbps，較上一代介面提高 50% 效能；並提供目前市場上最高儲存和記憶體容量的 uMCP 規格——分別為 256GB 和 12GB。

uMCP 是美光 LPDDR5 DRAM 的理想解決方案。5G 網路將於 2020 年起於全球大規模部署，美光次世代 LPDDR5 記憶體將可滿足 5G 網路對更高階記憶體效能及更低耗的需求。美光 LPDDR5 將支援 5G 智慧型手機以高達 6.4Gbps 的峰值速度來處理資料，這對避免資料瓶頸而言極為重要。

美光搭載 LPDDR5 的 uMCP5，將於 2020 年第一季起開始對部分合作夥伴送樣。



關於 Micron Technology, Inc.

我們是提供創新記憶體與儲存解決方案的業界先驅。透過這些全球品牌 — 美光 (Micron®) 和 Crucial® - 我們豐富的高效能記憶體與儲存技術產品組合正在改變世界使用資訊的方式，豐富生活樣貌。這些產品包含 DRAM、NAND、3D XPoint™ 記憶體和 NOR。以超過 40 年的科技領導地位做為後盾，我們的記憶體與儲存解決方案讓最具革命性的趨勢得以實現，包括在手機、資料中心、用戶端、消費者、工業、圖形、汽車和網路等重點市場的人工智慧、5G、機器學習與自動駕駛車輛發展。我們是 NASDAQ 上市公司，代號為 MU。如需關於 Micron Technology, Inc. 的詳細資訊，請瀏覽 micron.com。

© 2020 美光、美光標誌及其他所有美光商標皆為 Micron Technology, Inc. 資產。其他所有商標皆屬其各自擁有者所有。

美光媒體關係聯絡人

Erica Pompen
Micron Technology, Inc.
+1 (408) 834-1873
epompen@micron.com

美光投資人關係聯絡人

Farhan Ahmad
Micron Technology, Inc.
+1 (408) 834-1927
farhanahmad@micron.com